

日月光一〇六年度第一季業績簡訊

日月光半導體於台灣時間 106 年 4 月 28 日同步於美國及台灣兩地發佈一〇六年度第一季獲利報告，本公司一〇六年第一季之合併營業收入較一〇五年第四季下滑 14%，較一〇五年同期成長 7%，為新台幣 66,551 百萬元。茲將日月光一〇六年度第一季單季之合併營運成果、產品結構及其銷售地區比重表列如下：

合併綜合損益表（單位：新台幣百萬元）

項 目	106 年度 第一季	105 年度 第四季	105 年度 第一季
營業收入淨額	66,551	77,128	62,371
營業毛利	11,978	15,377	11,449
營業淨利（淨損）	5,228	8,133	5,206
稅前淨利（淨損）	3,857	9,669	5,374
所得稅利益（費用）	(886)	(1,274)	(1,318)
非控制權益	(402)	(430)	(174)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	2,569	7,965	3,882
基本每股盈餘(新台幣元)	0.33	1.04	0.51
稀釋每股盈餘(新台幣元)	0.30	0.88	0.40

綜合損益表 - 半導體封裝測試（單位：新台幣百萬元）

項 目	106 年度 第一季	105 年度 第四季	105 年度 第一季
營業收入淨額	38,385	43,463	35,543
營業毛利	8,835	11,647	7,832
營業淨利（淨損）	3,985	6,375	3,222
稅前淨利（淨損）	3,218	9,046	4,464
所得稅利益（費用）	(570)	(967)	(529)
非控制權益	(79)	(114)	(53)
歸屬予本公司業主之淨利（淨損）	2,569	7,965	3,882

半導體封裝測試銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	50
電腦	11
汽車, 消費性電子及其它	39
前十大客戶佔營收比重	47

測試業務產品組合	%
後段測試	81
晶圓測試	15
前段測試	4
測試資本支出金額	31 百萬美元
測試機台數	3,782 台

封裝業務產品組合	%
Bumping, Flip Chip, WLP & SiP	31
IC Wirebonding	58
Discrete and Others	11
封裝資本支出金額	120 百萬美元
打線機台數	15,963 台

電子代工服務銷售分析

產品應用別佔比	%
通訊	49
電腦	15
消費性電子	22
工業用	7
汽車電子	6
其它	1
前十大客戶佔營收比重	90
EMS 資本支出金額	3 百萬美元

日月光及矽品共同轉換股份協議最新消息

- 台灣公平交易委員會已核准通過日月光與矽品結合案。
- 日月光與矽品於 2016 年 8 月 25 日向中國商務部遞交文件，商務部於 2016 年 12 月 14 日正式立案審查。日月光已於 2017 年 4 月 12 日收到商務部通知本案進入第三階段延長審查。
- 日月光與矽品各已依美國聯邦貿易委員會的要求回覆相關文件，並將持續與聯邦貿易委員會配合以盡速完成調查。

根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，日月光公司 2017 年第二季的業績展望如下：

- 半導體封測事業第二季生意量與毛利率皆將與前季相當；
- 電子代工服務第二季生意量將與去年第二季與第三季平均相當；
- 電子代工服務毛利率將與前季相當。